

2020年度 京セラ株式会社 募集要項

1. 採用予定

【応募資格】

2020年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)

【採用予定】

理工系 280名 程度

【採用学科】

電気・電子系／機械系／制御系／物理系／情報・通信系／化学系／材料系／その他

【求める人材像】

- ・ 夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
- ・ 素直な心、ひたむきさを持っている人
- ・ グローバルな視点を持っている人
(今後の事業のグローバル展開を踏まえ、目安としてTOEIC600点相当の語学力がある方は、更に歓迎します)

《専攻分野と採用比率目安》

電気・電子／情報・通信系	機械／制御系	化学／材料系	物理系	その他
30%	30%	30%	5%	5%

2. 応募方法

(1) 修士・学部の方の応募方法について

次の2コース(プロダクト別採用コース/職種別採用コース)より選択いただき、ご応募ください。

※プロダクト別採用/職種別コースの併願はできません。

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募概要」及び「自己紹介シート記入要領」をご参照ください。

【1】プロダクト別採用コース(対象:学校推薦応募者限定)

学校推薦応募を検討されている方は、ご本人が希望するプロダクトへの配属を前提に、マッチング面談・選考に進んでいただきます。
「マッチング面談会」では、ご本人が希望される「プロダクト」と「技術専門性・応用性」(学部生の場合は「学業の理解度とポテンシャル」)について、該当部門との適性を確認いたします。

※①～⑩のうち、2つのプロダクト(第1希望/第2希望)を選択してください。

※6月1日以降にご連絡いただく場合には、ご希望のプロダクトへの応募が出来ない可能性があります。あらかじめご了承ください。

対象プロダクト:

- | | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------------|
| ①ファインセラミック部品 | ②車載用セラミック部品 | ③車載カメラ | ④液晶ディスプレイ |
| ⑤インダストリアルツール | ⑥光学用部品・機器 | ⑦セラミックパッケージ・基板 | ⑧有機パッケージ・基板 |
| ⑨ケミカル材料 | ⑩電子部品 | ⑪プリンティングデバイス | ⑫通信機器 |
| ⑬エネルギーデバイス | ⑭エネルギーシステム | ⑮医療機器 | ⑯宝飾・応用商品 |
| ⑰生産技術開発・精機 | ⑱ソフトウェア開発 | | |
- ※研究開発部門につきましては、各プロダクト(①～⑩)の中に含まれています。

【2】職種別採用コース (対象:学校推薦・自由応募者どちらでも可)

次の職種については、職種ごとに適性を確認し、該当部門への配属を前提に、マッチング面談・選考に進んでいただきます。

※⑲～⑳のうち、1つの職種を選択してください。

対象職種: ⑲特許・知的財産 ⑳情報ネットワーク・システムエンジニア ㉑施設管理・環境管理・安全防災

(2) 博士の方の応募方法について

随時、応募を受け付けております。ご希望の場合は、弊社HPから、マイページにログインいただき応募フローを確認してください。

ログイン後に、書類選考を行い合格された方にその後の選考に関してご案内いたします。3月以前にご応募の場合は、直接ご連絡ください。

(3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」を希望する方についても、学校推薦での応募を受け付けております。

応募・選考方法が技術コースとは異なりますので、ご希望の場合には弊社営業管理コース担当宛にご連絡ください。

(4) 留学生の方の応募方法について

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に弊社担当宛にご相談ください。

(5) 自由応募の方の応募方法について

選考方法が、学校推薦応募とは異なります。ご希望の方は、弊社新卒採用HPをご確認の上、ご応募ください。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

京セラ株式会社 人材開発課(技術コース担当) 今野・出口・瀧川

E-mail: shingo.konno.yb@kyocera.jp, youichirou.deguchi.xm@kyocera.jp

kanako.takigawa.yb@kyocera.jp

TEL : 075-604-3510 (直通)

※各コースへの応募書類をご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在申」と記載いただきますようお願いいたします。

京セラへの応募をお考えの方は

『京セラ プロダクト・職種別合同セミナー』へ

ぜひ、ご参加ください！各プロダクトより、事業内容や最先端技術、仕事の魅力をご紹介します！

【全国3か所で開催】

東京 3月12日(火) 博多 3月15日(金) 京都 3月20日(水)

弊社HPから、マイページにログインいただくと予約ができます。

「プロダクト別採用コース」「職種別採用コース」応募概要

※プロダクト別採用コースについては、学校推薦応募をお考えの方に限定させていただきます。

STEP.1 マッチング面談会

◆マッチング面談会の内容：
ご希望のプロダクト（第2希望まで）の部門責任者と面談
※面談結果は、面談終了後、2週間以内に就職担当教授様
もしくはキャリアセンター担当者様へフィードバックさせていただきます。

(1) 面談会申込方法

1.大学 ⇒弊社へご連絡	就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様より面談会参加希望学生を弊社担当までご連絡ください。
<p><面談会申込連絡内容></p> <p>①学生氏名 ②学部/研究科名 ③学科/専攻名 ④就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様のご連絡先をメール又はお電話で弊社担当へご連絡ください。</p>	
2.ご本人 ⇒弊社HPからエントリー	弊社、新卒採用サイトからエントリーしてください。 <京セラ採用HP URL: http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/ >
3.ご本人 ⇒マイページから応募データ入力	「マイページ」より、次の3点を入力し、データを送信してください。 ①「自己紹介シート」 ※面談資料として使用します ②「成績情報」 ※修士の方は学部部分も必要です ③「面談結果連絡先(就職ご担当教授・キャリアセンター等)」 ※自己紹介シートについては、研究概要等も入力いただくため、時間を要します。入力の際は、余裕を持って行ってください。
4.ご本人 ⇒データ送信・連絡	データ送信されましたら、弊社担当 今野・出口・瀧川までメールにてご連絡ください。

(2) 面談会申込
3月から申込をお受けいたします。なお、各プロダクトごと、採用定員に達した時点で応募を締め切らせていただきます。

(3) 面談会開催日程
3月下旬、4月下旬、5月下旬に開催を予定しています。
日程の詳細は、ご応募いただいた方に直接ご連絡いたします。
※選択されるプロダクトによっては、面談が複数日に及ぶ場合もあります。

(4) 面談場所
京都本社を予定しています。
※都合により、一部変更する場合があります。

(5) 交通費について
遠方者につきましては、弊社規定により交通費を補助いたします。
(詳細は、面談日時のご案内の際に連絡いたします。)

(6) マッチング面談会参加準備

1.弊社 ⇒ご本人へ日程の連絡	応募データ到着後、弊社よりSPI検査、面談日時・場所について、メールにて連絡いたします。
2.ご本人 ⇒SPI検査受検	面談日の2日前までに、テストセンターにて「SPI検査」を受検してください。
3.ご本人 ⇒面談資料作成	<p>◆下記資料2点を面談日当日にご持参ください。</p> <p>①技術PR資料 (A4/1~3枚、形式自由) ⇒ご自身の研究内容についてのPR資料 ②自己PR資料 (A4/1枚、形式自由) ⇒研究内容以外で自分を紹介するPR資料</p> <p>面談当日、各10部ご持参ください。 事前に送信いただいた「自己紹介シート」「成績情報」と併せて面談を実施いたします。</p> <p>推薦書またはそれに準ずる資料を当日ご準備いただける方は、ご持参ください。</p>

(7) マッチング面談会結果フィードバックについて
面談終了後、2週間以内に、マッチング結果を就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様へ電話又はメールにてフィードバックさせていただきます。

(8) 推薦書の発行について
マッチングが成立した場合には、推薦書の発行並びにその他提出書類の準備をお願いいたします。

STEP.2 最終選考

◆最終選考内容：面接

※原則として、面談でマッチング成立となったプロダクトへの配属を前提として、選考を行います。

(1) 最終選考にあたって

弊社 ⇒ご本人へ日程のご連絡	最終選考日が決定次第、弊社より日時・場所をご本人へメールにて連絡いたします。
<p><最終選考にご持参いただく書類></p> <p>①推薦書 ②修了見込証明書 ③健康診断書 ④成績証明書(学部・修士)の原紙</p> <p>※推薦書は、学部長・就職担当教授・指導教授のどなた様からでも構いません。</p>	
<p><選考に際しての注意事項></p> <p>◆大学側の都合により、マッチング成立後、推薦の決定または推薦状の発行までに日数がかかる場合には、事前に弊社担当へご相談ください。</p>	

(2) 最終選考日程
6月以降随時

(3) 最終選考場所
東京、京都、博多を予定

(4) 交通費について
最終選考については、弊社規定によりご自宅から面接会場までの交通費を全額支給いたします。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課(技術コース担当) 今野・出口・瀧川
E-mail: shingo.konno.yb@kyocera.jp, youichirou.deguchi.xm@kyocera.jp
kanako.takigawa.yb@kyocera.jp
TEL : 075-604-3510 (直通)
※各コースへの応募書類をご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。

「職種別採用コース(推薦応募)の方へ」

応募方法や面談会申込・面談会開催日程については、プロダクト別採用コースと同じ流れ(マッチング面談有)となります。
※詳細は、ご応募いただいた方に直接連絡いたします。

※最終選考は、プロダクト別採用コースのマッチング成立の方と同様に、6月以降を予定しています。

「6月1日以降に学校推薦で応募をされる場合の留意事項」

- ①配属先のプロダクト、職種を限定しない応募方法に変更になる可能性があります。応募の際に弊社担当までお問い合わせください。
- ②推薦応募が決定されましたら、就職担当教授様もしくはキャリアセンターご担当者様から弊社担当までご連絡ください。
- ③応募書類については、「マッチング面談会申込方法」と同様に、データ入力・送信を、マイページから行ってください。

自己紹介シート記入要領

☆ 応募前に必ず弊社採用HPより、エントリーしてください。 URL : <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/>
 エントリー後、ご自身のマイページより「自己紹介シート」及び「成績情報」を入力してください。

<自己紹介シート必要情報の入力に際して>

- (1) 「携わりたい技術分野」については、【◆表1 技術分野】から選択してください。(3つ以内)
- (2) 「希望するプロダクト及び職種」については、【◆表2 プロダクト及び職種】から選択してください。
 - ①プロダクト別採用コースの方 : プロダクト名称①~⑩から、2つ選択してください。 ※1つのプロダクトを強く希望される方は、1つだけでも構いません。
 - ②職種別採用コースの方 : その他技術関連(職種名称⑬~⑳)から、1つ選択してください。
- (3) 「卒業・修了研究概要とわらい」について、研究テーマが未定の方・学部生の方は、現在の専攻に基づいて最も関心を持っている研究分野もしくはご自身が最も得意とする分野と、その理由について入力してください。

【携わりたい技術分野及びプロダクト詳細】 ※マイページでも確認いただけます。

◆表1 技術分野				
・無機材料技術	・薄膜成膜技術	・パワーエレクトロニクス技術	・画像認識/画像処理技術	・振動/熱/流体関連技術
・有機材料技術	・微細加工技術	・電気特性評価技術	・ソフトウェア技術	・電池関連技術
・金属材料技術	・金属加工技術	・制御工学技術	・シミュレーション技術	・人工知能関連技術
・応用化学技術	・電気回路技術	・機械設計技術	・分析技術	・特許/知的財産管理技術
・材料特性評価技術	・電子回路技術	・機構設計技術	・信頼性工学技術	・情報システム管理技術
・セラミックプロセス技術	・高周波回路技術	・機械加工技術	・CAD/CAM技術	・施設環境管理技術
・電気化学技術	・情報通信技術	・光学設計技術	・IE/VE技術	・安全防災管理技術

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募概要」及び「自己紹介シート記入要領」をご参照ください。

◆表2 プロダクト及び職種

各プロダクト及び職種の内容については、「京セラ会社概要パンフレット」または「プロダクト・職種別合同セミナー」を参考にしてください。

プロダクト及び職種 ※その他技術関連を除き、全てのプロダクトに研究、開発・設計、製造技術、生産技術、品質評価技術等の職種があります。	専攻分野					
	電気・電子/物理系	機械・制御/物理系	情報・通信系	無機化学・材料系	有機化学・材料系	金属・結晶・半導体系
産業・自動車用部品						
①ファインセラミック部品 半導体・液晶製造装置用大型部品、サファイア単結晶製品、生活文化・産業機械用部品、環境・エネルギー関連用部品、医療機器用部品 等	○	◎	○	◎	○	○
②車載用セラミック部品 エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、セラミックヒーター、圧電材料/部品、ペルチェ素子 等	◎	◎	○	◎	○	◎
③車載カメラ 車載カメラモジュール、車載カメラ用部品(光学・電子・機構)、ソフトウェア 等	○	○	◎			
④液晶ディスプレイ 車載用液晶ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、産業機械用液晶ディスプレイ 等	◎	◎				
⑤インダストリアルツール 切削工具:セラミック、超硬合金、複合材料切削チップおよび金属製ホルダ(ターニング、ミリング)、ソリッド工具、プリント基板用ドリル、工業用精密ナイフ 電動工具:ステイプラー、鉄筋結束機、工作機器(インパクトドライバー等)、ガーデン機器(エッジトリマー等)、清掃機器(高圧洗浄機等)、DIY製品 空圧工具:ファスニング、ステイプラー、ネイラー	○	◎	○	◎	○	◎
⑥光学用品・機器 車載用・FA用・医療用・OA用・写真用レンズユニット、FA用・医療用光学ユニット 等	◎	◎	◎	◎	○	○
半導体部品関連						
⑦セラミックパッケージ・基板 <パッケージ> 半導体デバイス用パッケージ、通信デバイス用高周波パッケージ、電子部品用小型パッケージ、光半導体用パッケージ 等 <基板> 車載エンジン制御用セラミック基板、LEDランプモジュール用セラミック基板 等	◎	◎	◎	◎	○	○
⑧有機パッケージ・基板 <パッケージ> サーバー・ルーター・携帯端末用多層パッケージ 等 <基板・配線板> 携帯端末・車載用通信モジュール基板、パソコン・携帯端末用高密度配線板、ハイエンドサーバー・通信システム用大型基板 等	◎	○	○	◎	◎	○
⑨ケミカル材料 <半導体関連樹脂材料> 半導体封止材料、半導体・電子部品組立材料、化成品、熱硬化性成型材料、機能性シート 等		◎		◎		
電子デバイス関連						
⑩電子部品 コンデンサ、コネクタ、高周波デバイス(SAWフィルタ、高周波通信モジュール 等)、パワーデバイス	◎	◎	◎	○	○	○
⑪プリンティングデバイス 高速商業用インクジェットプリントヘッド、サーマルプリントヘッド、トナー方式プリンタ用アモルファスシリコン感光ドラム、LED光源 等	◎	◎	○	○	○	◎
コミュニケーション・生活・環境						
⑫通信機器 スマートフォン(携帯電話)、IoT機器、通信モジュール、アンテナ 等	◎	◎	◎	○	○	○
⑬エネルギーデバイス 太陽電池、SOFC、二次電池 等	◎	◎	○	○	◎	◎
⑭エネルギーシステム HEMS(家庭用エネルギー管理システム)、リチウムイオン蓄電システム、SOFCシステム 等	◎	○	◎	◎		◎
⑮医療機器 生体材料開発、再生医療開発、医療用デバイスの技術開発、医療・ヘルスケア関連機器のソフトウェア開発 等	○	○	◎	◎	◎	
⑯宝飾・応用商品 セラミック応用キッチン用品、セラミック応用ステーションナリー、日用品、再結晶宝石、ジュエリー 等		◎		◎	○	◎
生産技術開発関連						
⑰生産技術開発・精機 メカトロ技術開発、製造プロセス開発、生産設備/検査設備の開発・設計・製作、IoT/AI/センシング技術活用によるデータ解析、システム開発 等	◎	◎	◎	○	○	○
ソフトウェア関連						
⑱ソフトウェア開発 組み込みソフト開発、IoT・センサーネットワーク等の情報基盤技術開発、ビッグデータ・ヘルスケア等のサービスアプリケーション開発、画像処理・画像認識・画像センシング技術開発、人工知能等の先端ソフトウェア技術開発、産業向け自動化システム開発、クラウドシステム開発 等	◎	◎	◎			
その他技術関連						
⑲特許・知的財産 事業戦略の一翼を担う知財戦略の立案・遂行、自社発明の権利化・保護、他社とのライセンス契約関連業務 等	◎	○	◎	○	○	○
⑳情報ネットワーク・システムエンジニア 社内情報ネットワークシステムの企画・開発、保守管理 等	○		◎			
㉑施設管理・環境管理・安全防災 省エネ推進、排水/環境管理、電気設備設計、保守、労働安全衛生管理 等	◎	◎	○	○	○	○